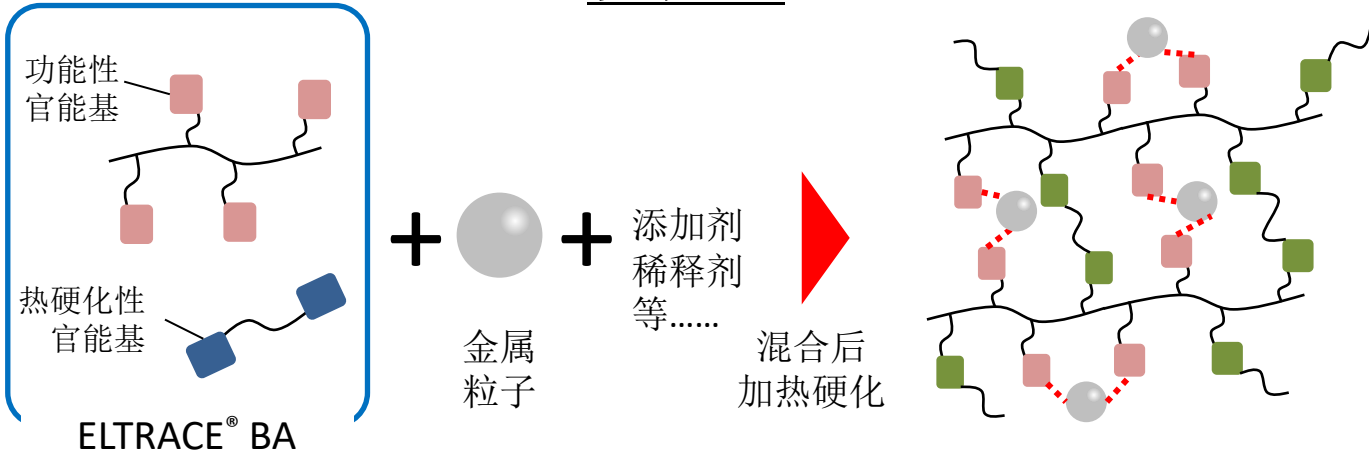


热硬化型导电性糊料用粘合剂
ELTRACE® BA

特征

- 1 液型的热硬化型丙烯酸系粘合剂
- 低气味、低粘度、低拉丝性，操作性良好
- 低温加热硬化，展现优异的导电性，可广泛应用于各种基材
- 硬化膜柔韧性良好，特别适合灵活性电路应用

设计理念



ELTRACE® BA 的功能性官能基有助于提高金属粒子的分散性。
所得糊料具有优异的粘度稳定性，表现出良好的体积电阻率。

一般性状

项目	性状	备注
外观	淡黄色透明液体	—
固含量(%)	约50	—
重均分子量	约10,000	—
粘度(Pa · s)	约5	E型粘度计、25℃
Tg(℃)	50	TMA法
线性膨胀系数(ppm/℃)	180/1,100	TMA法、α1/α2
储能模量(MPa)	330	DMA法、25℃
溶剂	松油醇系、乙二醇系等	—

拉丝性



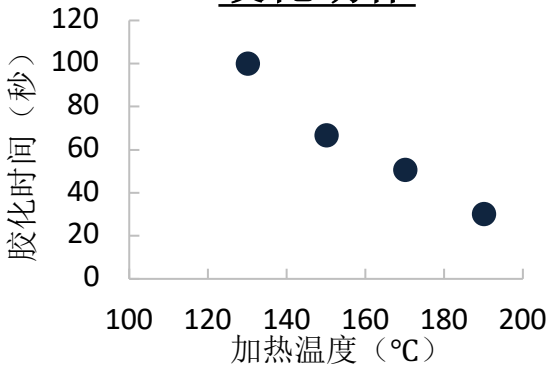
ELTRACE® BA



Bis-A 型环氧树脂

拉丝性低，表现出良好的印刷性

硬化动作



膜物性（仅粘合剂树脂）

		耐溶剂性	贴合性	弯曲性
		丙酮摩擦试验	划格试验	卷边试验
加熱条件	100℃×30分	有划痕	有剥离	有裂纹
	130℃×30分	无划痕	无剥离	无裂纹
	150℃×30分	无划痕	无剥离	无裂纹

130℃以上加热即可获得良好的硬化膜

导电性糊料调制示例

名称			配比	
			银糊料	铜糊料
糊料组分	银粒子（平均粒径：5 μm）		85%	—
	铜粒子（平均粒径：5 μm）		—	85%
	ELTRACE® BA-PH7030		8%	8%
	分散剂（ESLEAM® 221P）		0.5%	0.5%
	抗氧化剂（酚醛类）		—	0.5%
	溶剂（松油醇）		余量	余量
結果評価	体积电阻率（μΩ・cm）	加热条件：大气氛围 130℃×30分	28	25

我们可根据您的需求进行定制，欢迎垂询。

法规注册情况

日本(ENCS)	中国(IECSC)	中国台湾(TCSI)	韩国(AREC)	美国(TSCA)
※1	未收录	未收录	未收录	未收录

※1 低产量新化学物质

ELTRACE 和 ESLEAM 是日油株式会社的注册商标。

未经授权禁止转载或复制 ©2025 NOF CORPORATION

NOF CORPORATION Functional Materials Div.

20-3, Ebisu 4-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-6012 Japan

TEL : +81-3-5424-6685 FAX : +81-3-6837-5343

E-mail: additives_electronics@nof.co.jp

URL : https://www.nof.co.jp/